

JPS-9200応用データ紹介(4)

TRXPS測定例

全反射X線光電子分光法(Total reflection x-ray photoelectron spectroscopy, TRXPS)は照射X線の侵入深さが浅いため、従来 のXPSに比べ、表面感度が高い、スペクトルのバックグラウンドが低いなどの優れた特徴があり、表面超微量状態分析、薄膜 材料の表面数層の化学結合状態・島状成長・膜厚・界面状態の解析に有効です。 薄膜材料の表面数層の化学結合状態分析にTRXPS法を適用した結果を紹介します。

試料はマルチターゲットRFスパッタリング装置で作製したWS2/Cの多層薄膜で、試料のTEM観察像を右図に示します。TEM観察結果から WS₂層は1.2nm、C層は0.8nmの厚さであることが分かります。

下図にTRXPS(X線入射角度1.0°以下)で測定したワイドスペクトル(赤)と通常測 定のワイドスペクトル(青)を示します。



TEM観察結果(膜断面構造(明視野像))

 WS_2

が分かります。最表面はWSっです。



波形分離方法は次の手順で行いました。

(1) 通常測定Clsスペクトルを非対称関数(Sherwood 関数)を用いてClsスペクトル形 状を求める。



800 -

(2)この時得られた関数パラメータをTRXPS測定Clsスペクトルに当てはめる。 この結果、TRXPS測定Clsスペクトル中に通常測定では得られなかった2成分(C-O結 合、CH•CS,結合)が確認されます。

C-O、CH結合は試料表面汚染物に起因しますが、CS₂結合はC層に存在するものと思 われます。





試料ご提供:日本工業大学 システム工学科 渡部修一研究室